

2024-2030年中国芯片市场 评估与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片市场评估与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202402/441522.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片市场评估与投资战略研究报告》共十三章。首先介绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录： 第一章 芯片行业的总体概述 1.1 基本概念 1.2 制作过程 1.2.1 原料晶圆 1.2.2 晶圆涂膜 1.2.3 光刻显影 1.2.4 掺杂杂质 1.2.5 晶圆测试 1.2.6 芯片封装 1.2.7 测试包装 第二章 2018-2022年全球芯片产业发展分析 2.1 2018-2022年世界芯片市场综述 2.1.1 市场特点分析 2.1.2 全球发展形势 2.1.3 全球市场规模 2.1.4 市场竞争格局 2.2 美国 2.2.1 全球市场布局 2.2.2 行业并购热潮 2.2.3 行业从业人数 2.2.4 类脑芯片发展 2.3 日本 2.3.1 产业订单规模 2.3.2 技术研发进展 2.3.3 芯片工厂布局 2.3.4 日本产业模式 2.3.5 产业战略转型 2.4 韩国 2.4.1 产业发展阶段 2.4.2 技术发展历程 2.4.3 外贸市场规模 2.4.4 产业创新模式 2.4.5 市场发展战略 2.5 印度 2.5.1 芯片设计发展形势 2.5.2 政府扶持产业发展 2.5.3 产业发展对策分析 2.5.4 未来发展机遇分析 2.6 其他国家芯片产业发展分析 2.6.1 英国 2.6.2 德国 2.6.3 瑞士 第三章 中国芯片产业发展环境分析 3.1 政策环境 3.1.1 智能制造政策 3.1.2 集成电路政策 3.1.3 半导体产业规划 3.1.4 “互联网+”政策 3.2 经济环境 3.2.1 国民经济运行状况 3.2.2 工业经济增长情况 3.2.3 固定资产投资情况 3.2.4 经济转型升级形势 3.2.5 宏观经济发展趋势 3.3 社会环境 3.3.1 互联网加速发展 3.3.2 智能产品的普及 3.3.3 科技人才队伍壮大 3.4 技术环境 3.4.1 技术研发进展 3.4.2 无线芯片技术 3.4.3 技术发展趋势 第四章 2018-2022年中国芯片产业发展分析 4.1 中国芯片行业发展综述 4.1.1 产业发展历程 4.1.2 全球发展地位 4.1.3 海外投资标的 4.2 2018-2022年中国芯片市场格局分析 4.2.1 市场规模现状 4.2.2 市场竞争格局 4.2.3 行业利润流向 4.2.4 市场发展动态 4.3 2018-2022年中国量子芯片发展进程 4.3.1 产品发展历程 4.3.2 市场发展形势 4.3.3 产品研发动态 4.3.4 未来发展前景 4.4 2018-2022年芯片产业区域发展动态 4.4.1 湖南 4.4.2 贵州 4.4.3 北京 4.4.4 晋江 4.5 中国芯片产业发展问题分析 4.5.1 产业发展困境 4.5.2 开发速度放缓 4.5.3 市场垄断困境 4.6 中国芯片产业应对策略分析 4.6.1 企业发展战略 4.6.2 突破垄断策略 4.6.3 加强技术研发 第五章 2018-2022年中国芯片产业上游市场发展分析 5.1 2018-2022年中国半导体产业发展分析 5.1.1 行业发展意义 5.1.2 产业政

策环境 5.1.3 市场规模现状 5.1.4 产业资金投资 5.1.5 市场前景分析 5.1.6 未来发展方向

5.2 2018-2022年中国芯片设计行业发展分析 5.2.1 产业发展历程 5.2.2 市场发展现状 5.2.3 市场竞争格局 5.2.4 企业专利情况 5.2.5 国内外差距分析 5.3 2018-2022年中国晶圆代工产业发展分析 5.3.1 晶圆加工技术 5.3.2 国外发展模式 5.3.3 国内发展模式 5.3.4 企业竞争现状 5.3.5 市场布局分析 5.3.6 产业面临挑战 第六章 芯片设计行业重点企业经营分析

6.1 高通公司 6.1.1 企业发展概况 6.1.2 经营效益分析 6.1.3 新品研发进展 6.1.4 产品应用情况 6.1.5 未来发展前景 6.2 博通有限公司(原安华高科技) 6.2.1 企业发展概况 6.2.2 经营效益分析 6.2.3 新品研发进展 6.2.4 产品应用情况 6.2.5 未来发展前景 6.3 英伟达 6.3.1 企业发展概况 6.3.2 经营效益分析 6.3.3 新品研发进展 6.3.4 产品应用情况 6.3.5 未来发展前景 6.4 AMD 6.4.1 企业发展概况 6.4.2 经营效益分析 6.4.3 新品研发进展 6.4.4 产品应用情况 6.4.5 未来发展前景 6.5 Marvell 6.5.1 企业发展概况 6.5.2 经营效益分析 6.5.3 新品研发进展 6.5.4 产品应用情况 6.5.5 未来发展前景 6.6 赛灵思 6.6.1 企业发展概况 6.6.2 经营效益分析 6.6.3 新品研发进展 6.6.4 产品应用情况 6.6.5 未来发展前景 6.7 Altera 6.7.1 企业发展概况 6.7.2 经营效益分析 6.7.3 新品研发进展 6.7.4 产品应用情况 6.7.5 未来发展前景 6.8 Cirrus logic 6.8.1 企业发展概况 6.8.2 经营效益分析 6.8.3 新品研发进展 6.8.4 产品应用情况 6.8.5 未来发展前景 6.9 联发科 6.9.1 企业发展概况 6.9.2 经营效益分析 6.9.3 新品研发进展 6.9.4 产品应用情况 6.9.5 未来发展前景 6.10 展讯 6.10.1 企业发展概况 6.10.2 经营效益分析 6.10.3 新品研发进展 6.10.4 产品应用情况 6.10.5 未来发展前景 6.11 其他企业 6.11.1 海思 6.11.2 瑞星 6.11.3 Dialog 第七章 晶圆代工行业重点企业经营分析 7.1 格罗方德 7.1.1 企业发展概况 7.1.2 经营效益分析 7.1.3 企业发展形势 7.1.4 产品发展方向 7.1.5 未来发展前景 7.2 三星 7.2.1 企业发展概况 7.2.2 经营效益分析 7.2.3 企业发展形势 7.2.4 产品发展方向 7.2.5 未来发展前景 7.3 Tower jazz 7.3.1 企业发展概况 7.3.2 经营效益分析 7.3.3 企业发展形势 7.3.4 产品发展方向 7.3.5 未来发展前景 7.4 富士通 7.4.1 企业发展概况 7.4.2 经营效益分析 7.4.3 企业发展形势 7.4.4 产品发展方向 7.4.5 未来发展前景 7.5 台积电 7.5.1 企业发展概况 7.5.2 经营效益分析 7.5.3 企业发展形势 7.5.4 产品发展方向 7.5.5 未来发展前景 7.6 联电 7.6.1 企业发展概况 7.6.2 经营效益分析 7.6.3 企业发展形势 7.6.4 产品发展方向 7.6.5 未来发展前景 7.7 力晶 7.7.1 企业发展概况 7.7.2 经营效益分析 7.7.3 企业发展形势 7.7.4 产品发展方向 7.7.5 未来发展前景 7.8 中芯 7.8.1 企业发展概况 7.8.2 经营效益分析 7.8.3 企业发展形势 7.8.4 产品发展方向 7.8.5 未来发展前景 7.9 华虹 7.9.1 企业发展概况 7.9.2 经营效益分析 7.9.3 企业发展形势 7.9.4 产品发展方向 7.9.5 未来发展前景 第八章 2018-2022年中国芯片产业中游市场发展分析 8.1 2018-2022年中国芯片封装行业发

展分析 8.1.1 封装技术介绍 8.1.2 市场发展现状 8.1.3 国内竞争格局 8.1.4 技术发展趋势

8.2 2018-2022年中国芯片测试行业发展分析 8.2.1 IC测试原理 8.2.2 测试准备规划 8.2.3 主要测试分类 8.2.4 发展面临的问题 8.3 中国芯片封测行业发展方向分析 8.3.1 承接产业链转移 8.3.2 集中度持续提升 8.3.3 国产化进程加快 8.3.4 产业短板补齐升级 8.3.5 加速淘汰落后产能

第九章 芯片封装测试行业重点企业经营分析 9.1 Amkor 9.1.1 企业发展概况 9.1.2 经营效益分析 9.1.3 业务经营分析 9.1.4 财务状况分析 9.1.5 未来前景展望 9.2 日月光 9.2.1 企业发展概况 9.2.2 经营效益分析 9.2.3 业务经营分析 9.2.4 财务状况分析 9.2.5 未来前景展望 9.3 矽品 9.3.1 企业发展概况 9.3.2 经营效益分析 9.3.3 业务经营分析 9.3.4 财务状况分析 9.3.5 未来前景展望 9.4 南茂 9.4.1 企业发展概况 9.4.2 经营效益分析 9.4.3 业务经营分析 9.4.4 财务状况分析 9.4.5 未来前景展望 9.5 颀邦 9.5.1 企业发展概况 9.5.2 经营效益分析 9.5.3 业务经营分析 9.5.4 财务状况分析 9.5.5 未来前景展望 9.6 长电科技 9.6.1 企业发展概况 9.6.2 经营效益分析 9.6.3 业务经营分析 9.6.4 财务状况分析 9.6.5 未来前景展望 9.7 天水华天 9.7.1 企业发展概况 9.7.2 经营效益分析 9.7.3 业务经营分析 9.7.4 财务状况分析 9.7.5 未来前景展望 9.8 通富微电 9.8.1 企业发展概况 9.8.2 经营效益分析 9.8.3 业务经营分析 9.8.4 财务状况分析 9.8.5 未来前景展望 9.9 士兰微 9.9.1 企业发展概况 9.9.2 经营效益分析 9.9.3 业务经营分析 9.9.4 财务状况分析 9.9.5 未来前景展望 9.10 其他企业 9.10.1 UTAC 9.10.2 J-Device

第十章 2018-2022年中国芯片产业下游应用市场发展分析 10.1 LED 10.1.1 全球市场规模 10.1.2 LED芯片厂商 10.1.3 主要企业布局 10.1.4 封装技术难点 10.1.5 LED产业趋势 10.2 物联网 10.2.1 产业链的地位 10.2.2 市场发展现状 10.2.3 物联网wifi芯片 10.2.4 国产化的困境 10.2.5 产业发展困境 10.3 无人机 10.3.1 全球市场规模 10.3.2 市场竞争格局 10.3.3 主流主控芯片 10.3.4 芯片重点应用领域 10.3.5 市场前景分析 10.4 北斗系统 10.4.1 北斗芯片概述 10.4.2 产业发展形势 10.4.3 芯片生产现状 10.4.4 芯片研发进展 10.4.5 资本助力发展 10.4.6 产业发展前景 10.5 智能穿戴 10.6 智能手机 10.7 汽车电子 10.8 生物医药

第十一章 2018-2022年中国集成电路产业发展分析 11.1 中国集成电路行业总况分析 11.1.1 国内市场崛起 11.1.2 产业政策推动 11.1.3 主要应用市场 11.1.4 产业增长形势 11.2 2018-2022年集成电路市场规模分析 11.2.1 全球市场规模 11.2.2 市场规模现状 11.2.3 市场供需分析 11.2.4 产业链的规模 11.2.5 外贸规模分析 11.3 2018-2022年中国集成电路市场竞争格局 11.3.1 进入壁垒提高 11.3.2 上游垄断加剧 11.3.3 内部竞争激烈 11.4 中国集成电路产业发展的问题及对策 11.4.1 发展面临的问题 11.4.2 发展对策分析 11.4.3 产业突破方向 11.4.4 “十四五”发展建议 11.5 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析 11.5.1 全球市场趋势 11.5.2 国内行业趋势 11.5.3 行业机遇分析 11.5.4 市场规模预测

第

十二章 中国芯片行业投资分析 12.1 行业投资现状 12.1.1 全球产业并购 12.1.2 国内并购现状 12.1.3 重点投资领域 12.2 产业并购动态 12.2.1 ARM 12.2.2 Intel 12.2.3 NXP 12.2.4 Dialog 12.2.5 Avago 12.2.6 长电科技 12.2.7 紫光股份 12.2.8 Microsemi 12.2.9 Western Digital 12.2.10 ON Semiconductor 12.3 投资风险分析 12.3.1 宏观经济风险 12.3.2 环保相关风险 12.3.3 产业结构性风险 12.4 融资策略分析 12.4.1 项目包装融资 12.4.2 高新技术融资 12.4.3 BOT项目融资 12.4.4 IFC国际融资 12.4.5 专项资金融资 第十三章 中国芯片产业未来前景展望 13.1 中国芯片市场发展机遇分析 13.1.1 市场机遇分析 13.1.2 国内市场前景 13.1.3 产业发展趋势 13.2 中国芯片产业细分领域前景展望 13.2.1 芯片材料 13.2.2 芯片设计 13.2.3 芯片制造 13.2.4 芯片封测 附录： 附录一：国家集成电路产业发展推进纲要 图表目录：： 图表1 2018-2022年全球半导体市场销售规模 图表2 2018-2022年全球芯片销售规模 图表3 2022年全球IC公司市场占有率 图表4 2022年欧洲IC设计公司销售规模 图表5 2018-2022年美国半导体行业从业人员规模变动情况 图表6 2018-2022年人类每秒每\$1000成本所得到的计算能力增长曲线 图表7 28nm单个晶体管历史成本 图表8 日本综合电机企业的半导体业务重组 图表9 东芝公司半导体事业改革框架 图表10 智能制造系统架构 图表11 智能制造系统层级 图表12 MES制造执行与反馈流程 图表13 云平台体系架构 图表14 2018-2022年国内生产总值及其增长速度 图表15 2022年末人口数及其构成 图表16 2018-2022年城镇新增就业人数 图表17 2018-2022年全员劳动生产率 图表18 2022年居民消费价格月度涨跌幅度 图表19 2022年居民消费价格比2020年涨跌幅度 图表20 2022年新建商品住宅月同比价格上涨、持平、下降城市个数变化情况 图表21 2018-2022年全国一般公共预算收入 图表22 2018-2022年末国家外汇储备 图表23 2018-2022年粮食产量 图表24 2018-2022年社会消费品零售总额 图表25 2018-2022年货物进出口总额 图表26 2022年货物进出口总额及其增长速度 图表27 2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度 图表28 2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度 图表29 2022年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 图表30 2022年外商直接投资（不含银行、证券、保险）及其增长速度 更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202402/441522.html>